



**2021年度 第2四半期
決算説明会
イビデン株式会社 (4062)**

2021年11月01日

このプレゼンテーション資料には、2021年10月29日現在の将来に

関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。

世界経済・競合状況・為替変動等にかかわるリスクや不確定要因

により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。

2021年度上半期 実績

2021年度(上半期) 売上高・営業利益・純利益 実績 **IBIDEN**

売上高

(億円)

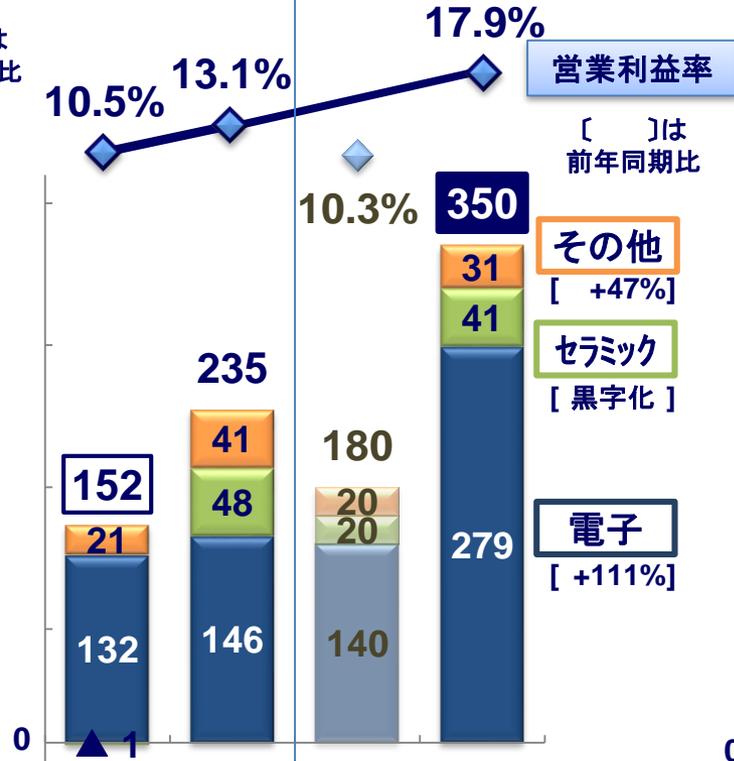
前年同期比
+36.0%



営業利益

(億円)

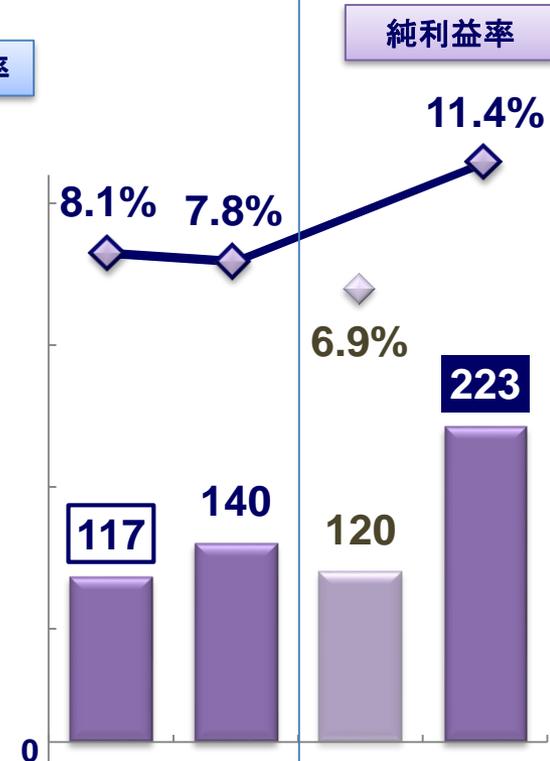
前年同期比
+130.7%



純利益

(億円)

前年同期比
+90.5%



実績	実績	8/4 開示	実績	
上半期	下半期	上半期	上半期	
20年度				21年度
106	104	105	109	為替(ドル)
119	124	125	129	為替(ユーロ)

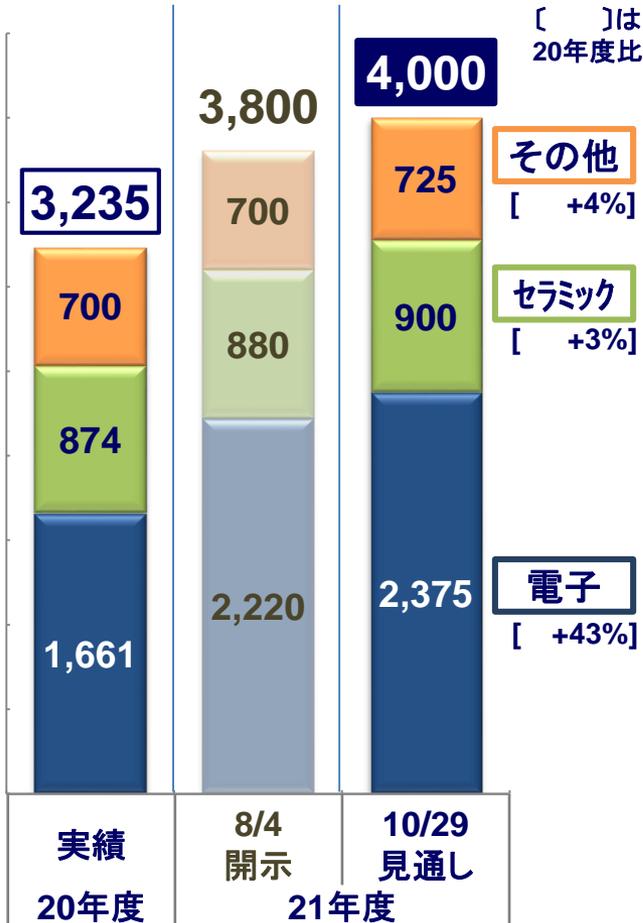
2021年度 見通し

2021年度(通期) 売上高・営業利益・純利益 見通し **IBIDEN**

売上高

(億円)

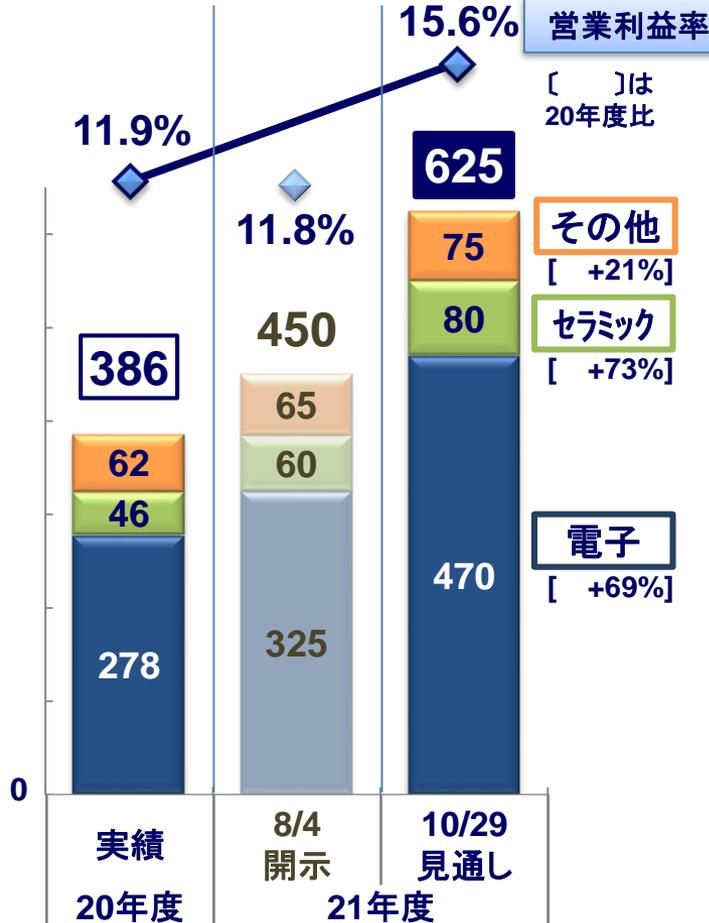
20年度比
+23.7%



営業利益

(億円)

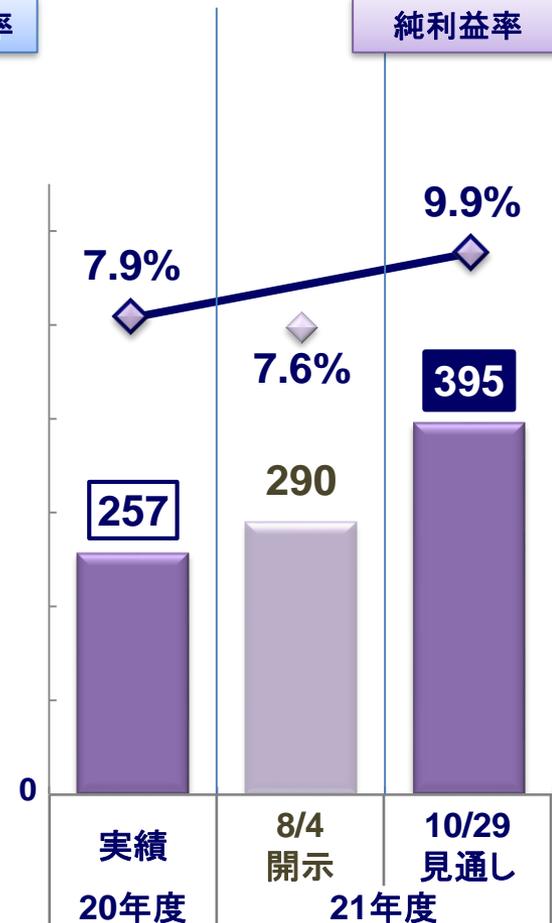
20年度比
+61.8%



純利益

(億円)

20年度比
+53.7%



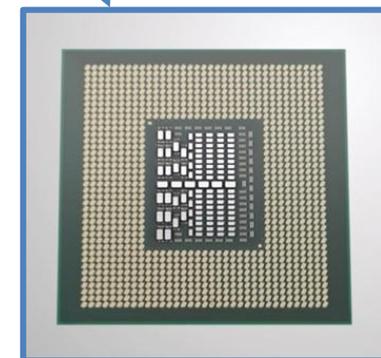
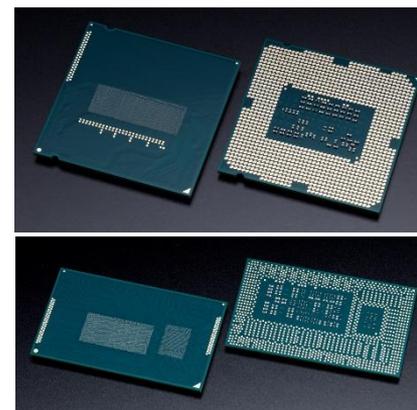
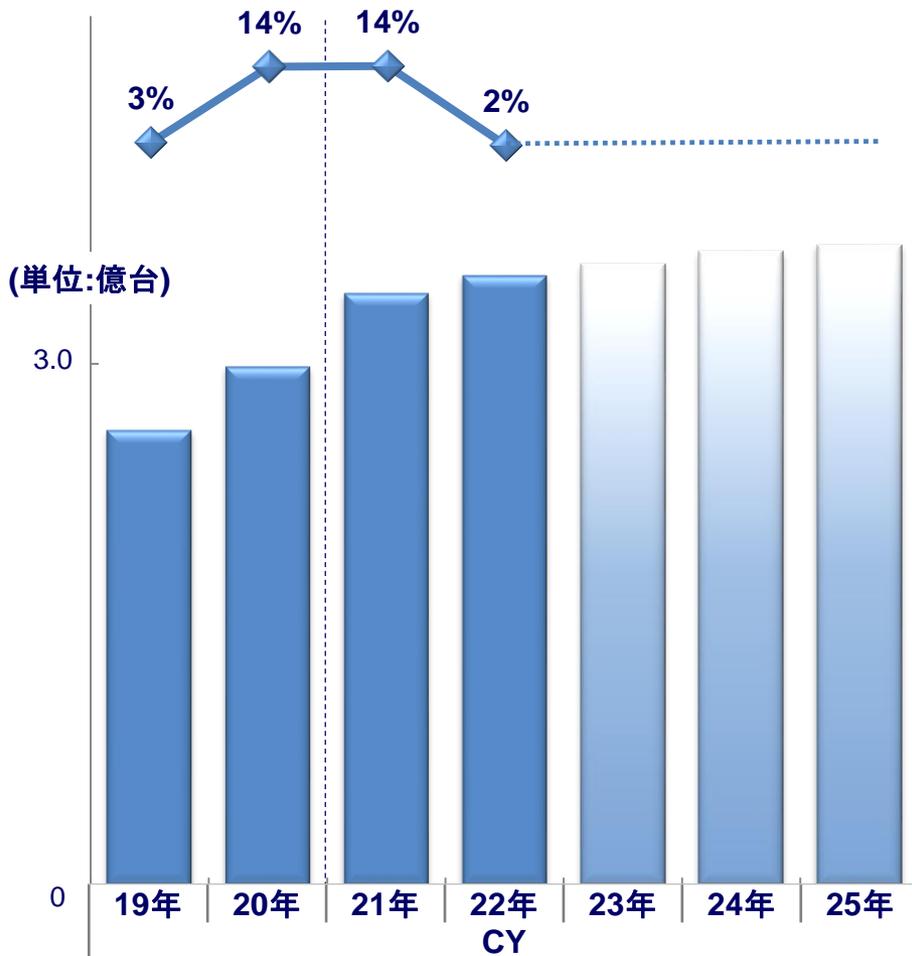
105	105	110	為替(ドル)
121	125	130	為替(ユーロ)

市場見通しと 当社事業展望

[電子] パソコン市場の動向

□ テレワーク・オンライン教育向けの需要一巡に伴い、中長期では緩やかな成長の見通し

◆ パソコン成長率 (外部調査会社の情報を基に推定)

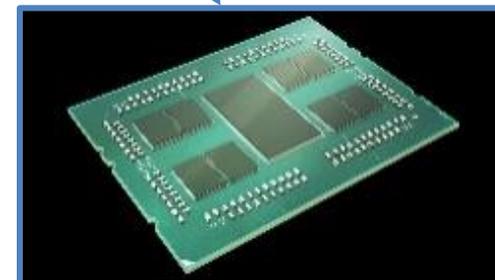
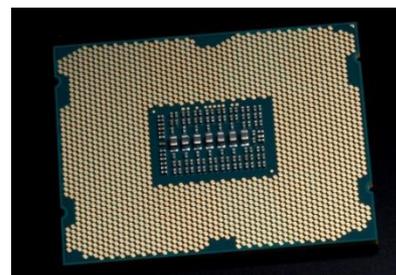
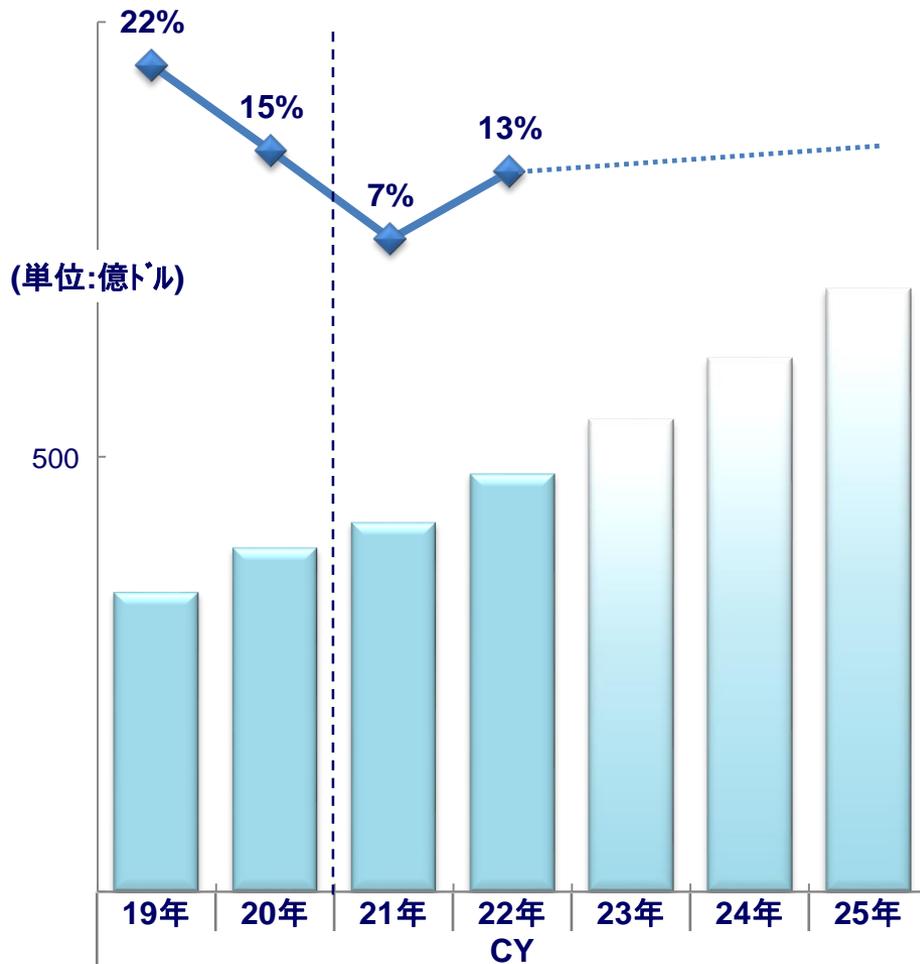


[電子] データセンター市場の動向

□ 企業活動を中心にデジタル化・クラウド化が継続、高水準の成長を堅持

(外部調査会社の情報を基に推定)

◆ データセンター成長率



□ ICパッケージ基板の微細化・高多層化・大型化により、製造工程(SAP)負荷が増加

SAP*需要(面積)

(顧客情報等を基に推定)

*Semi Additive Process

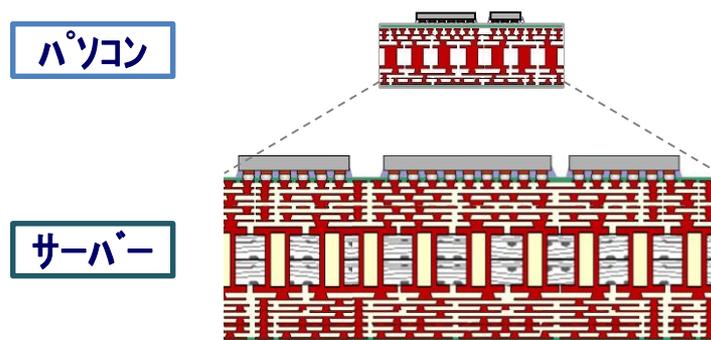
※19年度を「100」として指数化



アプリケーション別SAP負荷

	パソコン	サーバー
SAP層数	1.0 (4-x-4)	2.5 (10-x-10)
面積	1.0	3.6
SAP負荷	1.0	9.0

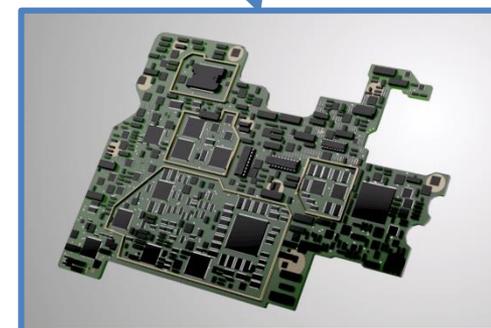
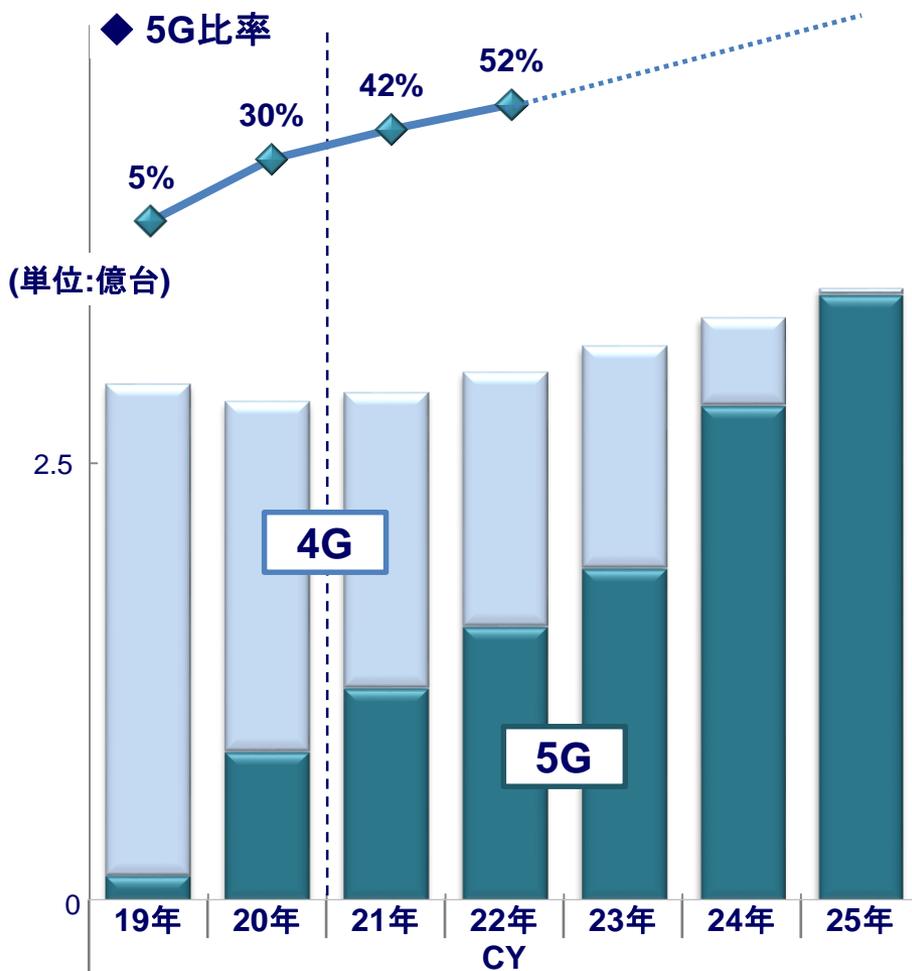
ICパッケージ基板の構造変化



[電子] ハイエンドスマホ市場の動向

□ ハイエンドスマホ市場全体は足元マイナス基調、5Gサービス開始により中期的に成長の見通し

(外部調査会社の情報を基に推定)

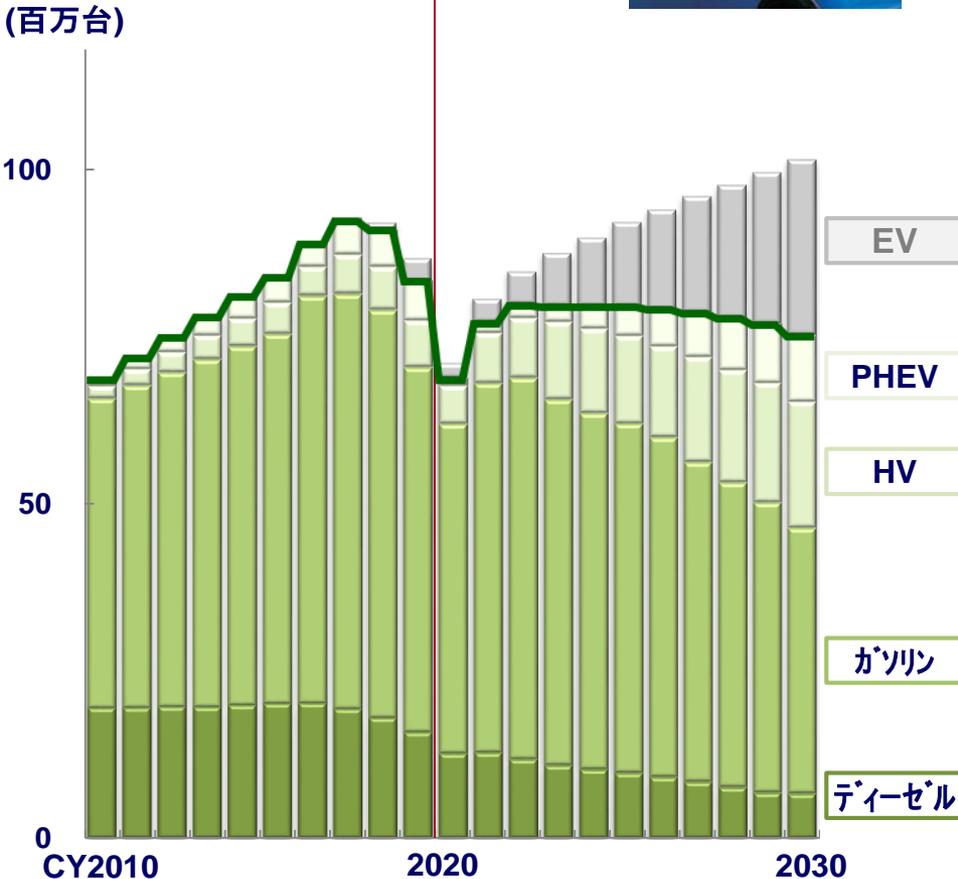


[セラミック] 自動車生産台数の見通し

- 乗用車市場 : 内燃機関搭載車は、一定水準残るも、電動化が加速する見通し
- 中・大型車市場 : 中国・新興国を中心とした排ガス規制の強化を背景に拡大

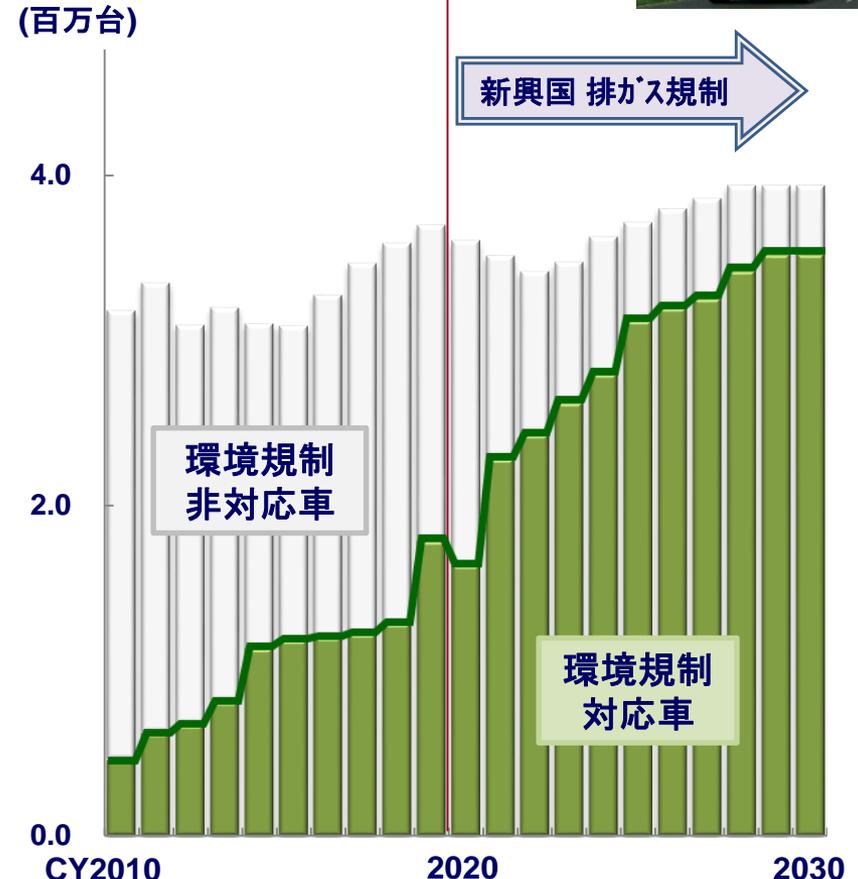
乗用車

(外部調査会社の情報を基に推定)



中・大型商用車

(外部調査会社の情報を基に推定)



[セラミック] 排気系事業

- ハンガリー・メキシコ・日本の3拠点を柔軟に活用し、グローバルな市場変化に対応する
- イビデンファインセラミック蘇州を軸に、中国市場の触媒担体保持・シール材の需要拡大を取り込む

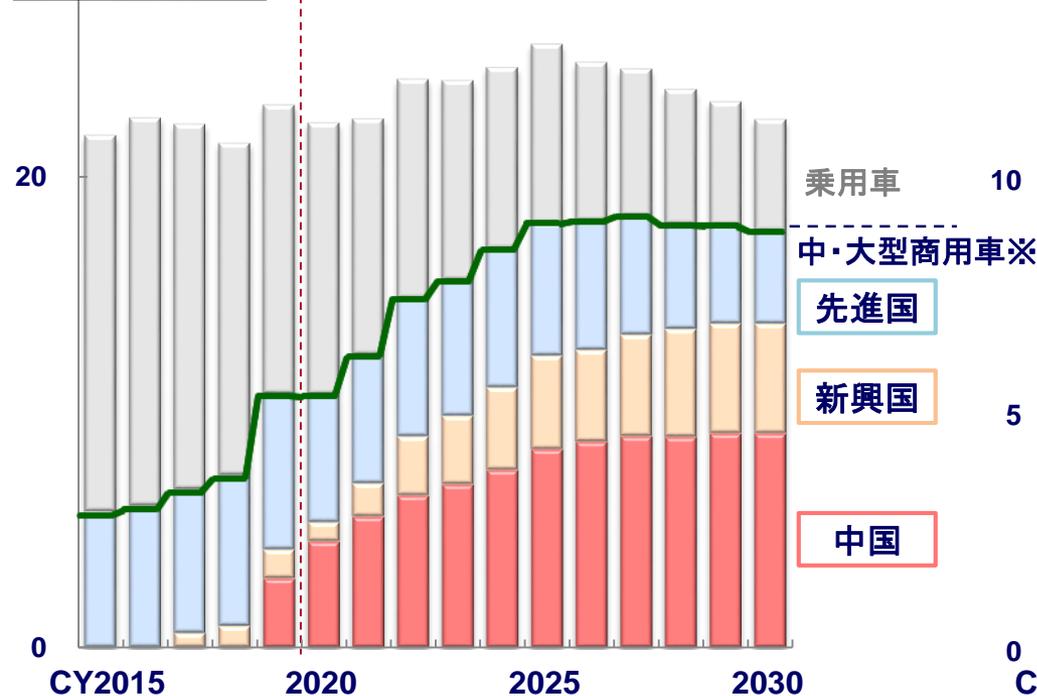
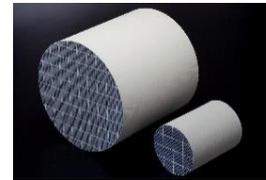
DPF市場

※乗用車の約3倍換算

(百万台)

(顧客情報等を基に推定)

中国 排ガス規制

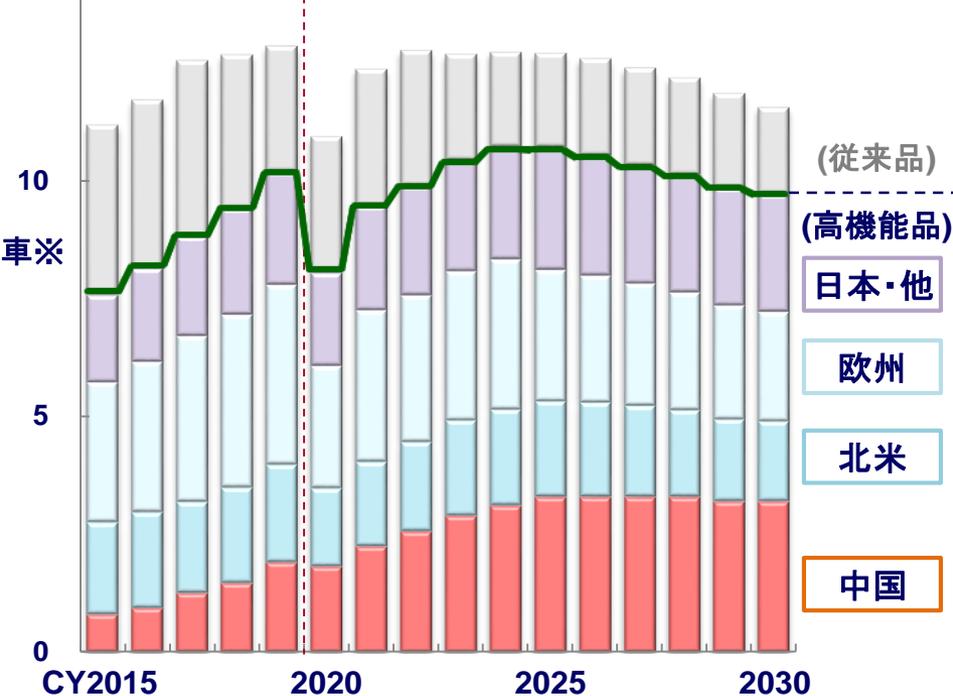


自動車用触媒担体・保持シール材

(千ton)

(顧客情報等を基に推定)

中国 排ガス規制



中期業績 見通し

設備投資(検収)額・減価償却費の計画

□拡大が見込まれるPKG市場への先行投資により、中期での事業成長の基盤を固める

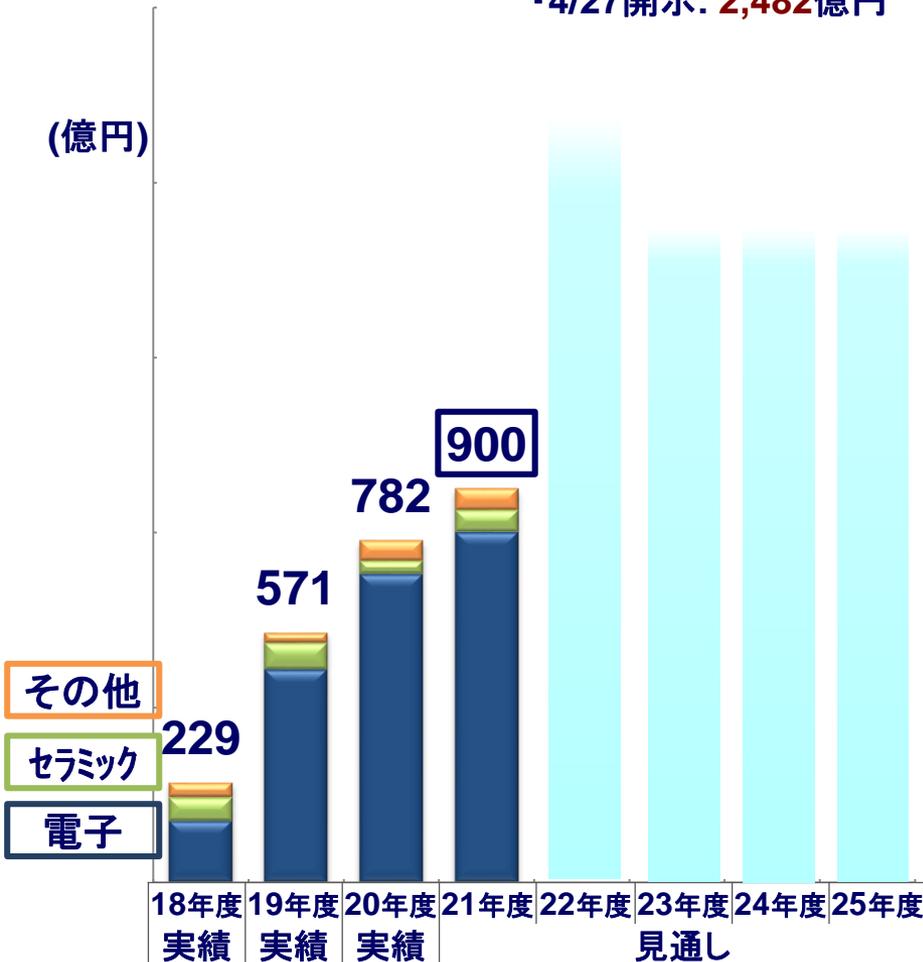
設備投資額

[18~22年度]
 ・20/10/28開示: 2,500億円
 [18~21年度]
 ・4/27開示: 2,482億円

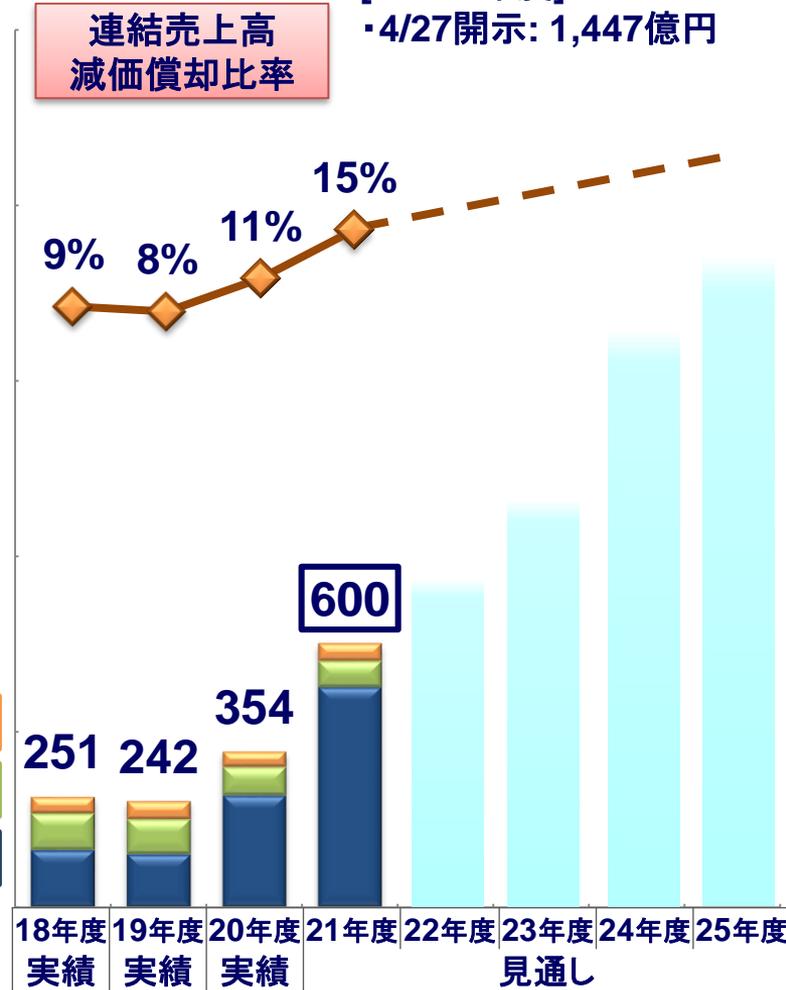
減価償却費

[18~22年度]
 ・20/10/28開示: 2,200億円
 [18~21年度]
 ・4/27開示: 1,447億円

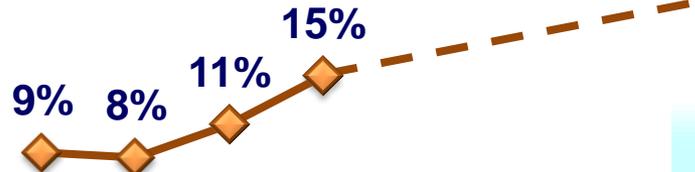
(億円)



(億円)



連結売上高
減価償却比率



□ 将来の国内事業拡大に備え、岐阜県大野町に新たな工場用地の取得を決定
更なる需要拡大が見込まれる高機能ICパッケージ基板の生産能力増強を軸に検討

<取得地の概要>

1. 所在地: 岐阜県揖斐郡大野町
2. 面積: 約150,000m²
3. 日程: 2023年9月末引渡し(予定)

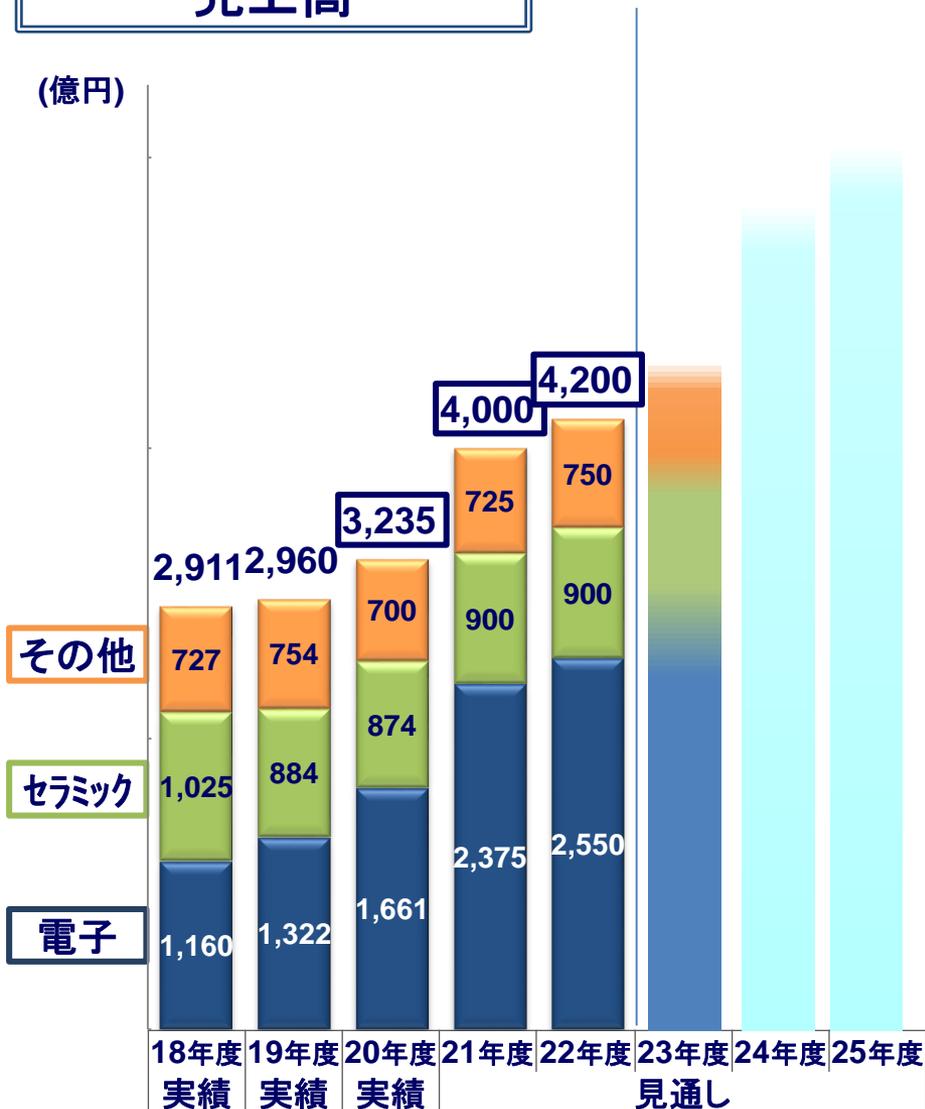


中期 業績見通し



売上高

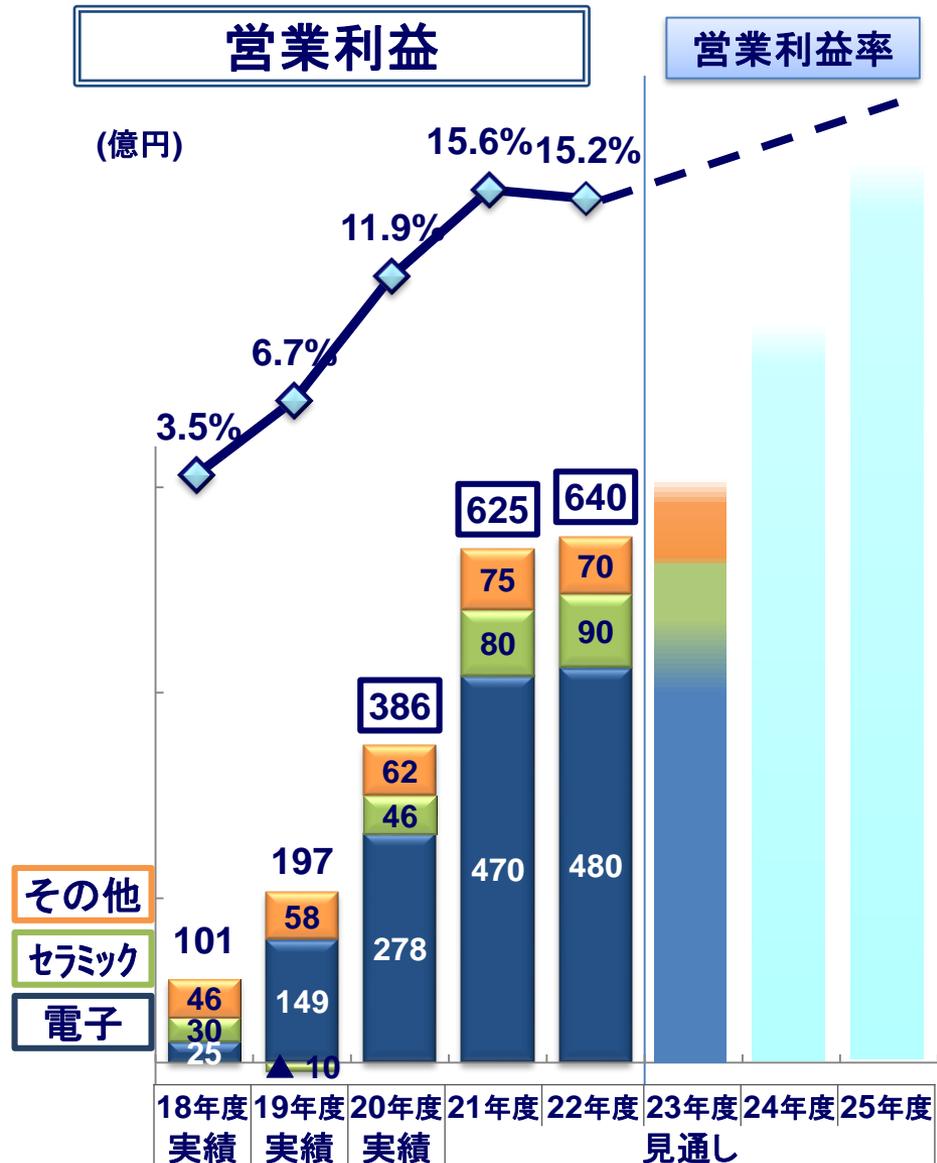
(億円)



営業利益

(億円)

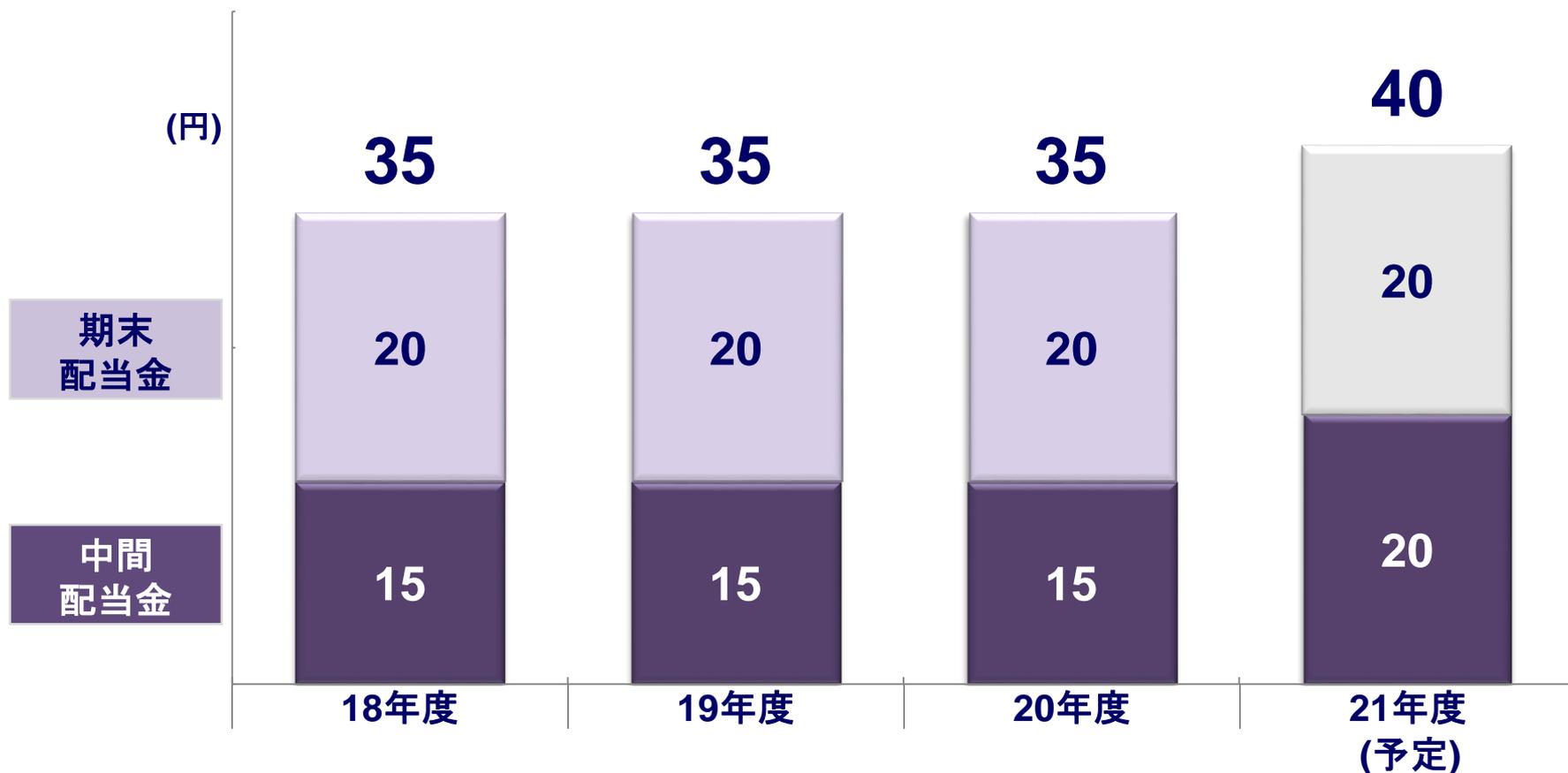
営業利益率



株主還元

- 成長投資・安定配当・利益還元を総合的に勘案し、21年中間配当を5円増配する
- 株主の皆様へのより公平な利益還元の観点から、株主優待制度を廃止する

一株当たり配当金



東京証券取引所 市場選択申請に関して

- 2021年7月9日 東京証券取引所より、
『新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する
一次判定結果』を受領
→プライム市場の上場維持基準への適合を確認



この結果を踏まえ、当社は、**プライム市場を選択し**、
東京証券取引所に申請することを決議

- 2021年10月29日 東京証券取引所へ、
「改訂コーポレートガバナンス・コード」に準拠(**フルコンプライ**)したコーポレートガバナンス報告書
を提出

引き続き、

- ・ より高いガバナンス体制の構築
- ・ 株主・投資家を始めとした様々なステークホルダーとの建設的な対話
- ・ 中期経営計画の達成

に取り組み、持続可能な成長による**中長期的な企業価値の向上**を目指す

脱炭素社会と SDGsへの取り組み

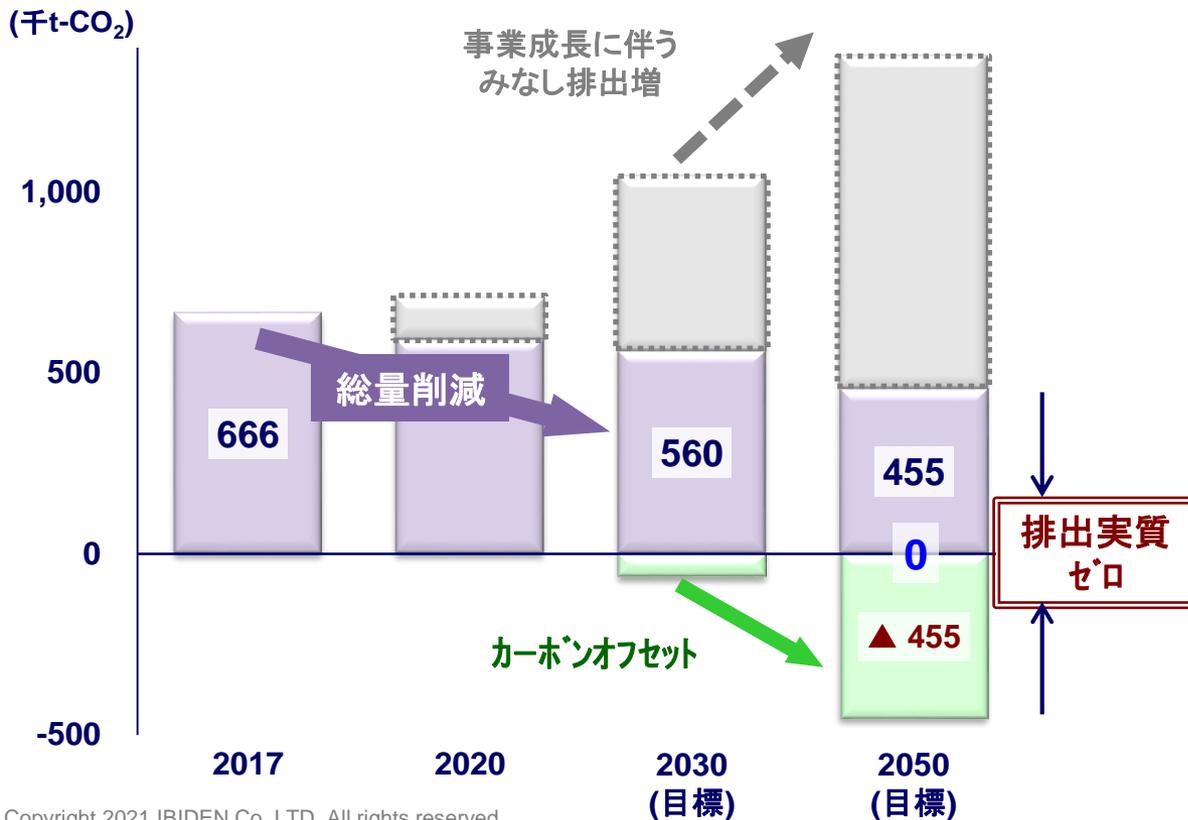
脱炭素社会への取り組み(GX推進)

脱炭素を実現する活動

TCFD TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES

*TCFD: 気候関連財務情報開示タスクフォース

気候変動問題への姿勢	2020年8月: TCFD提言への賛同を表明 2021年3月: 排出実質ゼロに向けた削減目標開示
目標	2030年度: 排出量原単位半減、排出総量16%削減(17年度比) 2050年度: 可能な限り早い段階で『排出実質ゼロ』をめざす



- **エネルギーを変える**
 - ・再生可能エネルギー導入
 - ・高効率コージェネレーションシステム活用

- **エネルギーを減らす**
 - ・最先端の生産設備導入
 - ・既存設備の省エネ改善

- **生産効率化の徹底**
 - ・DXを活用した生産性向上
 - ・ムダ・ロスの徹底削除(歩留り改善)

- **新たな分野への挑戦**
 - ・CO₂回収・固定化の技術開発
 - ・新エネルギーの活用検討

持続可能な社会(SDGs)への取り組み

■ 技術・事業活動を通じたアクション

デジタルイノベーションの実現

9 産業と技術革新の基盤をつくろう



- ・高機能・高信頼性のICパッケージ基板
- ・微細配線技術の革新



大気の水質の改善(環境汚染)

11 住み続けられるまちづくりを



- ・ディーゼル・パーティキュレート・フィルター
- ・排ガス浄化用触媒



脱炭素社会への取り組み(気候変動)

13 気候変動に具体的な対策を



7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに



- ・クリーンエネルギー供給
- ・先進セラミック製品
- ・森林保護、防災強化



■ 基盤活動の強化を通じたアクション

人財・企業風土の活性化

5 ジェンダー平等を實現しよう



8 働きがいも経済成長も



- ・ダイバーシティ推進(女性活躍など)
- ・働きがいと高い生産性の両立
- ・安全安心な労働環境



製品ライフサイクルの環境影響低減

12 つくる責任 つかう責任



13 気候変動に具体的な対策を



- ・温室効果ガスの排出抑制
- ・水使用の抑制、排水管理の徹底
- ・廃棄物・化学物質の管理



